

2023年9月21日

各位

会社名 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC
代表者名 代表取締役社長執行役員 金井 史幸
(コード番号：6525 東証プライム市場)
問合せ先 事業戦略本部 本部長 橋本 卓資(※注)
(TEL. 03-5297-8515)

(※注)2023年10月1日より、事業戦略本部は部署名を経営戦略本部に変更する予定であります。

中長期的な事業戦略および事業目標について

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC(本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：金井 史幸)は、この度、今後予想される市場環境や顧客ニーズの変化に適切に対応し、更なる高収益体質へと転換するための施策を推進するため、中長期的な事業戦略および事業目標を策定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 経営方針

当社グループは、2023年3月、ステークホルダーの皆様との対話をより一層深め、技術で未来を支えていく決意を込め、新たな企業理念として“KOKUSAI ELECTRIC Way”を制定いたしました。この企業理念の実現に向け、半導体製造装置専門メーカーとして社会的責任を強く自覚し、事業活動とESGの取り組み(環境・社会課題の解決、ガバナンスの強化)の両側面から経済価値及び環境・社会価値を追求することにより、SDGsの達成に寄与するとともに、持続可能な社会の実現と当社グループの持続的な発展の両立をめざしてまいります。

2. 事業環境の展望

- 半導体デバイス市場は、2010年から2022年の間に年平均成長率6.2%で推移してきました。今後も半導体デバイスの需要は消費者向けから産業向けへとシフトしながら拡大すると予測されており、2023年から2027年の5年では年平均成長率12.1%で成長すると予想されています^(注1)。
- 半導体製造装置市場は、2010年から2022年の間に年平均成長率10.2%で推移してきました。2023年から2027年の5年では年平均成長率9.3%で成長すると予想されており^(注2)、半導体構造の複雑化・三次元化に伴い、難易度の高い成膜と高い生産性を両立する半導体製造装置が求められ、市場拡大は継続する見通しです。
- 最近では、半導体デバイスの三次元(立体構造)化などに伴い、デバイスの構造がより深く、狭く、複雑になり、成膜が必要な表面積も拡大するため、難易度の高い高品質成膜を可能とするALD技術^(注3)に対するニーズが高まっています。一方で、このALD技術は、サイクリックなプロセスであり、そのプロセスの中でガスの流入や流出、また膜質を維持するために副産物の除去を行うため時間を要するプロセスになってしまうことが大きな課題になっています。ALD技術とバッチの組み合わせによる補完関係を実現した当社グループのバッチALD技術は、高難易度成膜と高生産性の両立を可能とするものであり、生産性に関するALDの問題の論理的な解決策となります。

(注1) 出典：TechInsights Manufacturing Analysis Inc. (VLSI) “WORLDWIDE SEMICONDUCTOR HISTORY AND FORECAST” 2023 (September)

(注2) 出典：TechInsights Manufacturing Analysis Inc. (VLSI) “Wafer Fab Equipment Sales by Application” 2023 (September)

(注3) 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

3. 中長期の事業戦略

当社グループは、半導体製造プロセスの前工程における「成膜」工程に注力しており、バッチ成膜装置、トリートメント装置で世界トップクラスのシェアを有しています。近年、半導体デバイス構造の複雑化、三次元化によってウェーハの表面が複雑な形状になり、高品質な薄膜等を形成するにはより高度な技術が必要とされています。これに対して当社グループは、難易度の高い成膜と高い生産性を両立するバッチ成膜技術や、高い生産性を維持しつつ形成された薄膜の膜質を改善するトリートメント技術を生かした高付加価値製品の販売拡大や研究開発に注力し、事業拡大を図ってまいります。また、装置のライフサイクル全体にわたって、メンテナンスや修理、部品供給、移設・改造などお客様のニーズに合わせたサービスの拡充を図ってまいります。加えて、今後の需要拡大に対応するための生産体制及び開発体制の拡充、DXを活用した生産効率向上、グループ全体でのESGの取り組みにも注力してまいります。

(1) 装置ビジネス

- バッチ成膜装置市場において、当社グループのバッチALD対応成膜装置は2022年の売上高世界シェア1位^(注4)となっています。上記の経営環境を踏まえ、高難易度成膜・高生産性を両立する技術優位性を生かしたバッチALD対応成膜装置を中心とする高付加価値製品の販売拡大や研究開発に注力し、事業拡大をめざします。
- トリートメント装置市場において、当社グループは2022年の売上高世界シェアNo.2^(注5,6)となっています。成膜後にプラズマや加熱により膜質の改善をさせる技術優位性を生かした高単価製品の販売拡大や研究開発に注力し、事業拡大をめざします。
- バッチ成膜装置とトリートメント装置の両方を有し、お客様のニーズに合った最適なソリューションを提供することができる当社グループ装置ビジネスの特徴を生かし、薄膜領域における当社グループのポジションを強固なものにしていきます。
- アプリケーション別には、3D NANDにおける技術的優位性をDRAMやLogicに展開し、NAND、DRAM、Logicのそれぞれでバランスのとれた成長をめざします。

(2) サービスビジネス

- 市場の変動を受けにくく、安定した需要の見込めるビジネスとして、装置の販売拡大による稼働台数の増加に合わせて、部品販売、保守サービス、装置の移設・改造をはじめ、お客様のニーズに合わせたサービスを拡充するとともに、パワーデバイス向け装置の販売拡大をはかることにより、事業の安定成長をめざします。

(注4) 出典：TechInsights Manufacturing Analysis Inc. (VLSI) “TI ALD Tools YEARLY” 2023 (April)

(注5) Gartner による半導体製造装置(前工程)セグメントにおける「RTP and Oxidation/Diffusion」を「トリートメント装置」と定義。

(注6) 出典：“Market Share Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2022, published April 17, 2023”

※本リリースに記載するガートナー・コンテンツ(以下「ガートナー・コンテンツ」という。)はシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてガートナーが発行したリサーチ・オピニオン又は見解を表すものであり、事実を述べるものではありません。ガートナー・コンテンツの内容は、いずれも公開された当時の内容であり、本書が公開された日の内容ではありません。また、ガートナー・コンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

4. 具体的施策

当社グループを取り巻く半導体デバイス市場は、スマートフォンやパソコン等の電子機器の需要低下を受けて、メモリーを中心に半導体デバイスの需要が停滞しており、また、米国政府による先端半導体関連製品の対中国輸出規制強化の影響もあり、半導体デバイスメーカーでは投資計画の先送りや抑制の動きが見られます。一方、自動車EV化等の加速により成熟品に対する半導体デバイスメーカーの投資は活発化しており、メモリーを中心とした半導体デバイスの在庫調整が進んでおります。また、AI、IoT、DXの拡がりによるデータセンターの拡充や環境負荷低減への投資(GX)等により、半導体関連市場は中長期的に大きな成長が見込まれます。

こうした状況をふまえ、2024年3月期における当社グループは、前述の経営戦略に基づき、今後の需要拡大に対応するための生産体制及び開発体制の拡充、DXを活用した生産効率向上、グループ全体でのESGの取り組みとして、下記の重点施策を推進しております。

- (1) 新技術・新製品の研究開発、新ドメインの確立
半導体デバイスの進化とお客様のニーズに応えるため、新技術・新製品の開発を推進いたします。半導体デバイスの複雑化・三次元化への対応に加え、新技術の開発についてもスピード感を持って推進いたします。
- (2) 装置ビジネスにおける付加価値の最大化
NAND分野で評価されている製品・技術をLogic、DRAM分野へと展開し、より付加価値の高い製品を提供することにより、事業の拡大と高収益化を推進いたします。
- (3) 生産・開発体制の拡充、生産効率の向上
中長期的な需要増加を見据え、富山県砺波市に2024年秋までの竣工をめざして砺波事業所を新設しております。この砺波事業所では、SX(Smart Transformation)を最大限活用することにより、生産効率が高く環境に優しい事業所をめざしております。この生産能力の拡充に合わせて、富山事業所の開発能力を拡充するとともに、韓国拠点のデモ評価エリアを拡張することにより、開発体制の拡充を図ってまいります。
- (4) サービスビジネスのさらなる拡大
部品販売・メンテナンスをはじめ、製品のライフサイクル全体でお客様のニーズに対応するサービスを提供するため、グループ全体でのサービスビジネス運営の強化を推進し、さらなる事業拡大をめざしてまいります。
- (5) グループガバナンスの定着・推進
グループ会社社長の現地人化を推進し、2023年6月末までに全てのグループ会社で現地人社長が就任しており、グループ全体でコーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの取り組みを継続的に強化してまいります。
- (6) 新たなスコープでのDX化の推進
業務基幹システムの刷新を含むDX化に関して、開発のスコープを絞りつつ、早期グローバル展開も視野に入れ、より現実的で事業運営に寄与できるDXプロジェクトを推進してまいります。
- (7) グループ全体でのサステナビリティ経営の実現
新しい企業理念である“KOKUSAI ELECTRIC Way”のもと、グループ全体でサステナビリティ経営レベルを高度化していくフェーズに移行し、より一層、企業の社会的責任を自覚しながら事業とESGの両側面での取り組みを強化してまいります。

5. 中長期の事業目標

当社グループは、WFE（Wafer Fab Equipment:半導体製造装置市場）の市場規模および市場成長を前提として、以下の中長期事業目標を設定いたしました。

	2022年3月期実績	2023年3月期実績	中長期事業目標
売上収益	2,454億円	2,457億円	3,000～3,300億円
装置ビジネス売上比率	74%	69%	70～75%
サービスビジネス売上比率	26%	31%	25～30%
売上総利益率	43.6%	41.0%	43.0%以上
研究開発費(対売上収益比率)	4.0%	5.1%	6%程度
調整後営業利益率 ^(注7)	32.4%	26.1%	28～30%
(参考)前提としたWFE市場規模	\$90 Bn(2021年) ^(注8)	\$100 Bn(2022年) ^(注8)	\$110～120Bn

(注7) 調整後営業利益は以下の算式により算出しております。

調整後営業利益＝営業利益（IFRS）－その他の収益＋その他の費用＋企業結合により識別した無形資産等の償却＋スタンドアロン関連費用＋マネジメントフィー＋株式報酬費用（業績連動型株式報酬制度に係るものを除く）

(注8) 当社グループ推定

6. 株主還元に関する方針

当社は、研究開発投資・設備投資の強化を最優先に、将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する安定的・継続的かつ積極的な利益還元を経営の重要課題と考え、連結配当性向20%から30%程度を目安に剰余金の配当を行っていくことを予定しております。加えて、ネットキャッシュ^(注9)がプラスに転換した後は、さらなる株主利益と資本効率の向上に向け、有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フロー^(注10)の70%程度に相当する金額を配当及び自己株式取得に充当することをめざしてまいります。また自己株式については、保有する株式数の上限を設定し、上限を超過した株式は消却することを基本としております。

(注9) ネットキャッシュ＝現金及び現金同等物－有利子負債

(注10) 有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー－有利子負債の分割償還額

上記の表中の数値は一部を除き適用ある会計基準に基づいて作成された当社の連結財務諸表上の数値ではなく、監査の対象となっておりません。2022年3月期実績及び2023年3月期実績の財務数値については当社の連結財務諸表をご確認ください。

なお、中長期の事業目標は、将来の市場動向に関する一定の前提に基づき設定されたものであり、将来の特定の事業年度における財務報告上の数値に関する当社の見込み又は計画を示したのではなく、また、当社が上記の中長期事業目標を達成することを保証するものではありません。

※この文章は、当社の企業情報等を一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず当社の株式その他一切の有価証券の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成及び公表されたものではありません。

また、本記者発表文に記載されている当社の計画、見積もり、予測、予想その他の将来情報については、本記者発表文の作成時点における当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、経済状況の変化、市場環境の変化及び他社との競合等により、本記者発表文の内容又は本記者発表文から推測される内容と大きく異なることがあります。

また、本記者発表文に記載される業界、市場動向又は経済情勢等に関する第三者作成の資料に基づく情報は、当該資料の作成時点で入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、当社がその真実性、正確性、合理性及び網羅性について保証するものではありません。また、今後の状況の変更等が当該資料の内容に影響を与える可能性があります。当該資料に基づく情報を更新、修正又は確認する義務を負うものではありません。当該資料の内容は事前の通知なく変更されることがあります。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。